



# Virtex-4 および Virtex-5 FPGA に使用されるフリップ チップ BGA パッケージ材質の BT から ABF への変更

XCN11004 (v1.1) 2011 年 5 月 2 日

製品変更通知

## 概要

この通知は、Virtex®-4 および Virtex®-5 FPGA フリップ チップ パッケージのビルドアップ層のサプライヤーが追加されることをお知らせするものです。

## 内容

先日日本で発生した地震の影響によって、フリップ チップ パッケージのビルドアップ層に使用されている Bismaleimide-Triazine (BT) 樹脂材不足が世界各地で生じています。ザイリンクスは安定して供給を継続するため、ABF 材を使用したパッケージ ビルドアップ層の評価を行いました。ABF 材は、[XCN09013](#) および [XCN10013](#) で通知されているように、その他の Virtex®-II Pro FPGA、Virtex-4 FPGA、Virtex-5 FPGA 製品で既に評価済みで使用されています。パッケージフォーム、形状、および機能に変更はありません。

## 該当製品

この変更は、コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード デバイスの全スピードグレード、パッケージ、温度範囲の製品に該当します。オートモーティブおよび高信頼性/航空宇宙デバイスへの影響はありません。次の表に、該当製品ファミリを示します。

表 1: 該当製品

製品番号	パッケージ
XC5VSX240T	FF(G)1738
XC5VLX330T	FF(G)1738
XC5VLX330	FF(G)1760
XC5VLX220T	FF(G)1738
XC5VLX220	FF(G)1760
XC5VLX155T	FF(G)1738
XC5VLX155	FF(G)1760
XC5VLX110T	FF(G)1738
XC5VLX110	FF(G)1760
XC4VSX35	FF(G)668
XC4VLX60	FF(G)668
XC4VLX25	FF(G)668

## キーデータおよび注文情報

2011 年 4 月 18 日の 30 日後から、パッケージに BT を使用した製品および ABF を使用したものが混在出荷されます。

## 品質評価データ

ABF パッケージ材は Virtex-II Pro FPGA、Virtex-4 FPGA、および Virtex-5 FPGA デバイスで評価済みであり、今日現在一部のデバイスで使用されています。Virtex-4 FPGA および Virtex-5 FPGA デバイスの品質評価データとデバイス信頼性レポートは、[UG116](#) から入手可能です。また、この XCN に関連する広範な品質評価データは、下記「参考資料」にある [RPT141](#) から入手できます。

## お問い合わせ先

注意事項：JESD46-C に従い、この通知から 30 日以内にお客様から確認通知がなかった場合、この変更は許諾されたとみなされます。

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ：ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://www.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、[ザイリンクス アンサー#18683](#) を参照して下さい。

## 参考資料

Qualification Report (RPT141)

<https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=140202>

デバイス信頼性レポート (UG116)

[http://japan.xilinx.com/support/documentation/user\\_guides/ug116.pdf](http://japan.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug116.pdf)

## 改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2011/04/18	1.0	初版リリース
2011/05/02	1.1	<a href="#">表 1</a> から XC5VLX30-FF(G)324 を削除。

## Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XNC11004、バージョン 1.1、2011 年 5 月 2 日発行) を翻訳したものです。